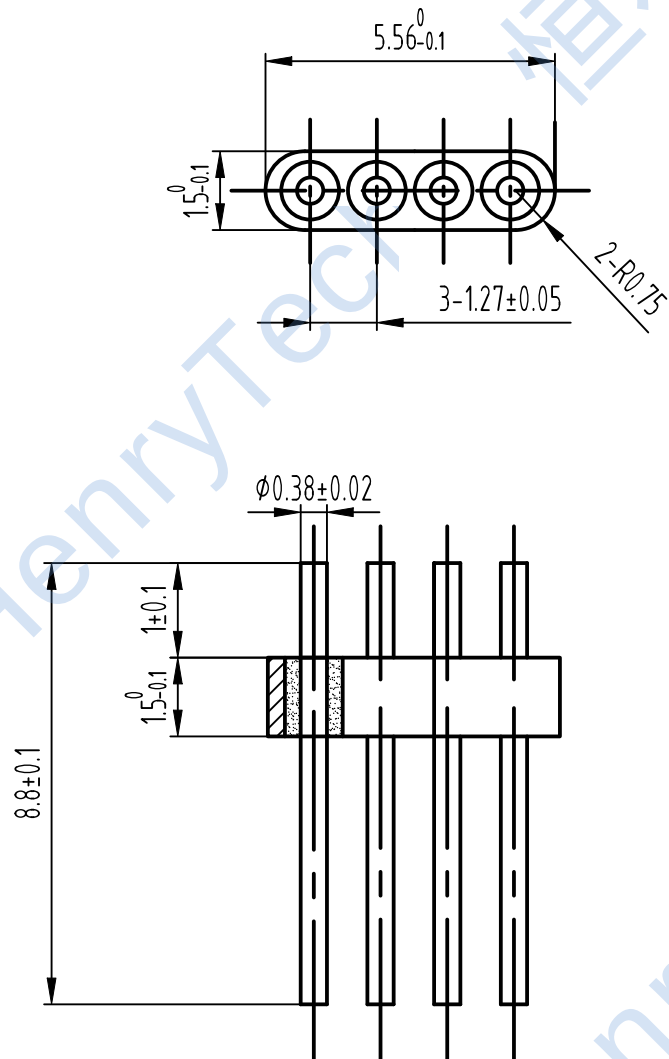




借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega @500V$
2. 介电耐压： $\geq 300V$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3 / S$
4. 使用寿命： ≥ 500 次
5. 温度范围： $-65 \sim +155$
6. 镀层厚度： $\geq 1.27 \mu m$ 软金

签 字

日 期

装配图

HN-LP4-0.38-1.27(8.8-1)
M

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

标记	处数	更改文件号	签字	日期	
设计			标准化		
审核					
工艺			日期		

图样标记

重量

比例

7:1

共 页

第 页